



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24322000000264564370

开票日期: 2024年07月23日

共2页 第1页

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司				销售方信息	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	50000	0.0575221238938	2876.11	13%	373.89	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	450000	0.0575221238938	25884.96	13%	3365.04	
*集成电路*封装芯片		HS8112 SOP16	只	100000	0.0619469026549	6194.69	13%	805.31	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	170432	0.0575221238938	9803.61	13%	1274.47	
*集成电路*封装芯片		YL9000P SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96	
*集成电路*封装芯片		HS26P10 SOP14	只	18024	0.0575221238938	1036.78	13%	134.78	
*集成电路*封装芯片		HS8112 SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65	
*集成电路*封装芯片		HS0860 SOP16	只	78868	0.0619469026549	4885.63	13%	635.13	
*集成电路*封装芯片		HS8112 SOP16	只	100000	0.0619469026549	6194.69	13%	805.31	
*集成电路*封装芯片		YL9000P SOP16	只	41654	0.0619469026549	2580.34	13%	335.44	
*集成电路*封装芯片		HS8112 SOP16	只	69714	0.0619469026549	4318.57	13%	561.41	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	150000	0.0619469026549	9292.04	13%	1207.96	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	200000	0.0619469026549	12389.38	13%	1610.62	
*集成电路*封装芯片		HS16F3211H SOP14	只	130518	0.0575221238938	7507.67	13%	976.00	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65	
*集成电路*封装芯片		HS16F3211H SOP14	只	250000	0.0575221238938	14380.53	13%	1869.47	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	150000	0.0575221238938	8628.32	13%	1121.68	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	350000	0.0619469026549	21681.42	13%	2818.58	
*集成电路*封装芯片		HS16F3211H SOP14	只	149366	0.0575221238938	8591.85	13%	1116.94	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	250000	0.0575221238938	14380.53	13%	1869.47	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	200000	0.0619469026549	12389.38	13%	1610.62	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	50000	0.0575221238938	2876.11	13%	373.89	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	100000	0.0575221238938	5752.21	13%	747.79	
*集成电路*封装芯片		HS9000P-P16 SOP16	只	52413	0.0619469026549	3246.82	13%	422.09	
*集成电路*封装芯片		HS2303-P SOP16	只	350000	0.0619469026549	21681.42	13%	2818.58	
*集成电路*封装芯片		HS2300-P SOP14	只	51319	0.0575222101149	2951.98	13%	383.76	
*集成电路*封装芯片		HS2303-P	只	50000	0.0619469026549	3097.35	13%	402.65	
小 计						¥231206.48		¥30056.79	
合 计						¥243595.86		¥31667.41	

开票人: 周曰莲



电子发票（增值税专用发票）



发票号码：24322000000264564370

开票日期：2024年07月23日

共2页 第2页

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司				销售方信息	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司		
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W		
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*集成电路*封装芯片		SOP16 HS2303-P SOP16	只	200000	0.0619469026549	12389.38	13%	1610.62
小 计						¥12389.38		¥1610.62
合 计						¥243595.86		¥31667.41
价税合计（大写）			⊗ 贰拾柒万伍仟贰佰陆拾叁圆贰角柒分			（小写） ¥275263.27		
备注	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行; 银行账号: 10400101040258099;							

开票人：周曰莲